

LF6 공정 Flash의 Disturb 문제

Leader of Microcontroller Technology Global Top Smart MCU Innovation Company

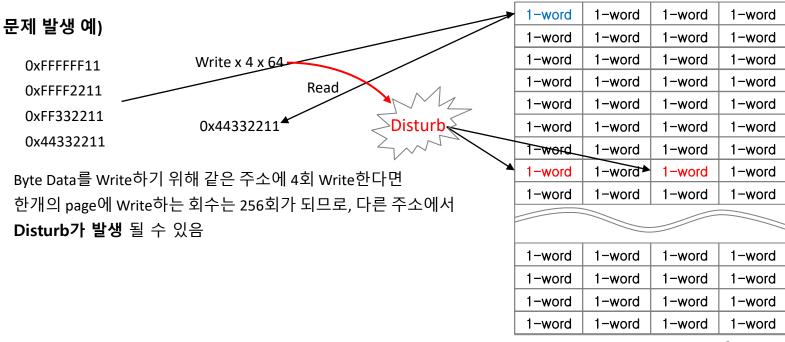


2023. 10. 16 어보브반도체(주)

1. Disturb 발생 원인



LF6 공정의 Flash는 Word단위로 program을 하도록 가이드하고 있습니다. 한개의 Page는 64-word로 구성되어 있으므로 한개의 Page에 64회만 Write해야 합니다. 이 회수를 넘길 경우 같은 Page내에서 Disturb가 발생 할 수 있습니다.



<1-Page (64-word)>

2. Disturb 발생 이론

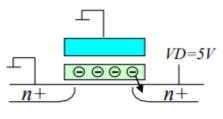


동일 Page(Wordline)의 다른 Cell programming시, 선택되지 않은 Erased cell이 비정상적으로 soft-Programming되거나 Programmed cell이 비정상적으로 soft-Erase 되는 현상이 발생합니다.

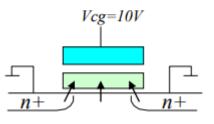
Cell programming 진행 시 그림과 같이 선택되지 않은 cell에 floatinggate로 전자가 유출되거나 유입되며 Erase/Program Vth 이상 전자의 유입 혹은 유출이 발생하면 Erase cell이 soft Programing 되거나 Programmed cell이 soft Erase cell로 변경됩니다.

LF6 공정의 경우 FLASH spec은 Page당 64회 이상 Program 진행 시 disturb 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

양산 테스트 진행 시 flash의 모든 page당 64회 Program 진행 하여 disturb 문제 발생여부를 screen하고 있습니다.



Drain Disturb

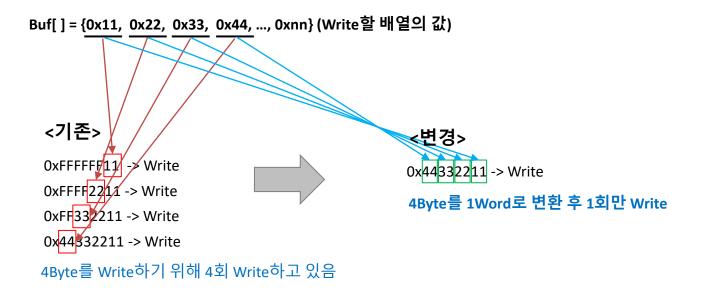


Gate Disturb

3. Disturb 발생의 회피



아래와 같이 Word 단위 PGM을 통해 회피 할 수 있습니다.



결론: 4Byte를 1Word로 변환 후 1회만 Write하여 Disturb를 회피 할 수 있습니다.

주의: 한 개의 Page에 64회를 초과하여 Write하지 않도록 해주세요.

4. LF6 공정의 Flash를 사용하는 제품 군



- HART-m320(A33G52x)
- HART-m330(A33G53x)
- A34M418
- A34M420(LF6S)

※ LF6S 공정도 LF6와 같이 Disturb문제가 발생 할 수 있음



ABOV Semiconductor, more than meets the eye!



